



伊斯卡全新亮相登陆 CIMES2012

New Technology of Iscar at CIMES2012

伊斯卡刀具国际贸易(上海)有限公司

伊斯卡即将亮相6月12~16日在北京举办的第十一届中国国际机床工具展览会(CIMES2012)。伊斯卡重装上阵的形象墙,将侧重推介金属加工在各工业领域的运用,重新定义伊斯卡的展示形象。

伊斯卡专为刀具推荐系统ITA开辟了展示专区。在面向市场推出24h全天候服务的刀具推荐系统ITA后,伊斯卡一直致力于增补完善ITA推荐所涵盖的加工方式。目前,ITA已覆盖了铣削、ISO车削、车削-切槽加工及切断加工、孔加工。而iPhone、iPad版本的开通,更方便用户在加工现场选取刀具。

伊斯卡特别设计了切槽刀具展台,重点展示其闻名于世的切槽刀具。借切槽刀展示伊斯卡的实力,以点带面,提升形象。

成功的立装自夹式槽刀(TANG-GRIP)系列,业已增补新槽型及新合金牌号。还将展示各式切断刀设计,可在不同应用条件下对多种被加工材料进行加工。夹持于专机的特制切断刀,用于切断管件。这里,亦将展示采用2种不同的技术、不同的理念加工管件,一是采用切

刀,一是采用槽铣刀。

在车削-切槽加工领域,伊斯卡向来可提供各种不同的加工解决方案。束魔重型霸王刀(SUMOGRIP),新合金牌号及卷屑槽,专注于重型加工;五角霸王刀(PENTACUT),带5个切削刃,用于精密切槽;另外,Tiger 14则聚焦于重型宽槽的加工。

在端面切槽加工方面,伊斯卡着重突出MINCUT,可应用于端面车削、螺纹加工、切槽、清根、精整。

在ISO车刀展台,彩色系束魔涂层将作为其最新研发成果予以展示。IC6015及IC6025用于车削不锈钢;IC806用于车削高温合金;强韧晶须陶瓷IW7用于车削Inconel工件。

车削刀片新槽型也将展出,诸如:用于中型加工的M3M槽型;用于重型加工的H3N、H4N、H5N槽型。

伊斯卡一直非常重视孔加工,现场侧重于展示可换刀头式束魔变色龙钻(SUMOCHAM)高生产率孔加工解决方案。展台将展示全系列的束魔变色龙钻,直径范围为7~25.9mm。双导向条刀头则是这个系列中的亮点,采用该刀头可获得高尺寸精度、高质量的孔。FCP刀头作

为束魔变色龙钻的最新成员,可用于加工平底孔。而束魔变色龙钻杆,则在原来的基础上,增补了DCN 12XD及8XD钻深,为标准品。

深孔钻展示区,传统的BTA系列旁,将陈列DR-DH深孔钻。BTA系列,分单管钻系列及双管钻系列,钻深比大,刀头直径范围宽,在深孔加工中,表现出色。

DR-DH深孔钻,大直径钻杆,钻深7XD及以上,可用于标准卧式加工中心、车床及多任务机床。其独特之处在于,可夹持于常规刀柄,对冷却液压力及流量无特别要求。钻头可加工直径范围为25.4~69.5mm,提供单排屑槽和双排屑槽2种形式。

展台还将展示夹持可转位刀片式钻头、整体硬质合金钻头,以及针对复合材料钻削加工特别设计的钻头。

铣削方面,伊斯卡以展示高生产率刀具为主:高效经济的双面螺旋刃飞碟铣刀(HELIDO UPFEED H600),基于双面刀片设计,带6个切削刃,独特的前刀面设计;另外,还将成系列成规模地展示大进给刀片。

针对整体硬质合金立铣刀, 发展的焦点可集中于不等螺旋角精铣刀。该铣刀承继了防振降噪立铣刀(CHATTERFREE) 坡走铣的特点及加工无接刀的特点, 而不等螺旋角的设计, 则令其减振效果更明显, 铣刀寿命更长。变形金刚立铣刀(MULTI-MASTER) 系列, 也将展示其所具备的多样选择性的优势。

在面铣加工应用中, 视角聚焦于双面螺旋刃铣刀(HELIDO 845) 系列。该铣刀带 45° 主偏角, 可选用不同的卷屑槽铣刀片, 加工各种材料; 刀片夹持于 SOF 铣刀盘, 该刀盘通用性佳。可夹持带 16 个切削刃的 ONMU05 刀片, 该刀片非常经济, 配

合修光刃刀片使用, 可获取高的表面光洁度, 主要推荐应用于高生产率半精铣及精铣加工。采用同一把 SOF 铣刀盘, 还可夹持带 8 个切削刃的 SNMU 13 刀片, 同时也可夹持修光刃刀片, 用于更大切削深度的加工及大余量的金属切除。

伊斯卡推荐高生产率的螺旋刃蝴蝶铣刀(HELITANG T490) 系列, 立装夹持刀片, 有 8、13、16mm 3 种规格, 切削深度更大, 也应用于玉米铣刀。

此外, 伊斯卡的双面螺旋刃铣刀(HELIDO H490) 系列, 独特的螺旋切削刃设计刀片, 有 9、12、17mm 3 种规格, 应用范围广, 可有效降低成

本。

技术领先的束魔涂层技术(SUMO TEC), 融合了伊斯卡所有铣刀新系列, 也显著延长了铣刀寿命。这一技术也使得在实现高切削速度、高生产率的同时, 还可获得更长的刀具寿命。

蝴蝶插铣刀(TANGPLUNGE), 是高效插铣加工的理想刀具, 刀片立装夹持, 有 06、10、16 mm 3 种规格。此刀具在模具、航空工业以及其他工业领域得到了广泛的应用。

本届展会, 伊斯卡还将关注航空等工业领域, 推出各工业领域相关样本, 并展示在各工业领域的解决方案。(责编 夏宛)

凌华科技宣布推出高亮度智能屏系列的最新产品

SP-860 of ADLINK

凌华科技

近日, 计算机产品领导者之一的凌华科技, 公开推出其首款以 ARM 架构为解决方案的 SP-860 高亮度智能屏。SP-860 是一套性能强大且富含多功能的独立系统显示器, 整合 LCD 面板、CPU、触控屏幕于一体, 拥有低功耗、OS 弹性(WinCE、Linux 或 Android 均适用)、以及强大开发与客制化支持等优势。

“SP-860 适用于包括 POS、静态显示、室外包括恶劣环境在内的多种应用。”凌华科技的产品经理黄智源表示, “SP-860 预留的接口, 让未来的功能扩充性更加便利。SP-860 的结构设计重点在于尽可能减少零组件、提高产品可靠度、简化维护, 同时降低单位成本。”

SP-860 采用全机一体设计, 搭配 4:3 TFT-LCD 显示器及 TI Cortex A8 处理器。最新款的高亮度智能屏内建 Wi-Fi+ BT SIP 模块, 可通过堆栈实现扩展并支持 2 组 LAN 端口。选购产品包括四线电阻式触控传感器及阳光下可视高亮度显示器。SP-860 支持 Linux 2.6.32、WinCE 6.0 及 Android 2.3.4 等操作系统。

SP-860 入门套件包含带有 Linux 的 NAND 闪存, 同时也可从 micro-SD 记忆卡开机。Linux 安装可利用超级终端机, 从 RS232 端口发布指令进行设定, 并可快速还原所删除的文件。

高亮度智能屏产品采用高度整合、轻薄短小、可立即开发的弹性设计, 让您的终端产品迅速问世、降



低开发风险成本并简化物料管理。这是市场上首套整合 CPU、网络及显示器于一身的单机面板装置, 在应用产品的外壳设计上更具弹性。高亮度智能屏完全整合 LCD 面板、触控屏幕和主板, 使设计者能专注于处理最终应用所需的 I/O 板设计。采用高亮度智能屏不仅可降低设计风险, 更能缩减系统开发时间。

凌华科技提供系统客制化服务, 便于客户通过共同设计开发, 快速提供完全客制的面板运算系统。凌华科技也提供以应用需求为基准的标准外壳参考设计, 以便于机壳内快速组装高亮度智能屏及 I/O 控制模块。

(责编 夏宛)